

ADEKAの新基幹研究所「半導体イノベーションセンター」が本格稼働

～創業から培った技術力を結集し、最先端をリードする総合半導体材料メーカーへ～

What's New

2026年

2025年

2024年

2023年

2022年

2026年07月02日

ADEKAは、ADEKAテクノロジーセンター久喜（埼玉県久喜市、旧久喜開発研究所）に建設した新研究棟「半導体イノベーションセンター」の本格稼働をお知らせいたします。

半導体は現代の戦略物資として、世界的に投資が活発化しており、市場は2026年に1.5兆円規模へ前倒しで拡大するなど、急速な成長を続けています。日本は半導体製造において、装置と材料で競争優位性を持っており、半導体材料は日系企業が世界シェア50%超を占め、技術革新の源泉を担っています。他方、AIやデータセンター等高度ICT社会の進展に伴う情報処理の高速化や消費電力の低減を背景に、半導体の高集積化や高積層化などの技術革新ニーズが高まっており、サプライチェーン全体でゲームチェンジが求められています。

ADEKAは、先端半導体の成膜工程で使われる高誘電材料（ALD材料）や、先端フォトリソグラフィ工程で使われる化学増幅型レジスト（CAR）用光酸発生剤（PAG）、金属酸化物レジスト（MOR）用金属化合物など、先端半導体に欠かせないキーマテリアルを提供してきました。

また、半導体材料事業は、今後の当社利益拡大を担うプロフィットセンターであり、直近5年間で研究開発・製造・人員強化へ累計約521億円と積極的な先行投資を実施しています。

当センターは、ADEKAテクノロジーセンター東京（東京都荒川区、旧尾久中央開発研究所）にあった半導体材料開発研究所と、環境材料開発研究所内の後工程に関わる研究室を集約・拡張した基幹研究所です。研究開発エリアは従来比2.7倍と大幅に拡張。クリーンルームは、ワンフロア・850平方メートル超（従来比2.5倍）の中にALD成膜装置等の製品評価機器を複数台設置するなど、先端開発テーマを同時並行かつ早期実用化を叶える設備を完備しています。これにより、強みである前工程材料のさらなる拡大と、後工程向け新規材料への領域拡大を目指し、日本の当センターと、韓国・台湾・米国といったADEKAグループの拠点が連携し、より一層お客様のニーズに迅速にお応えしていきます。

ADEKAは、当センターを半導体材料の事業拡大に向けた基幹拠点と位置づけ、研究人員の倍増や研究開発施設の拡張、生産設備増強など、経営資源を集中的に投じていく考えです。2035年度には、ありたい姿として、同分野の営業利益325億円（当社全体の営業利益の4割超）を掲げ、総合半導体材料メーカーとなることを目指してまいります。

【ADEKA】半導体イノベーションセンター イメージ映像

ADEKA公式チャンネル (ADEKA CORPORATION)



見る

概要

名称	ADEKA 半導体イノベーションセンター
所在地	埼玉県久喜市菖蒲町昭和20 ADEKAテクノロジーセンター 久喜 内
投資金額	約120億円
規模	地上7階建 鉄骨造 建築面積：1,990平方メートル、延床面積：11,545平方メートル
主な施設	研究所実験室、クリーンルーム、分析室、会議室 他

施工	株式会社大林組
スケジュール	着工：2024年4月、竣工：2026年4月、開所：2026年6月
研究人員	約150名（2026年7月1日時点）

開発製品例

ADEKAが長年強みとしてきたALD材料やリソグラフィ材料は、主に前工程において、半導体の微細化に貢献してきました。今後、HBMや先端ロジックICをはじめとする先端デバイスの構造変化（裏面電源供給、CoWoSなどの先端パッケージ）には、主に材料の後工程のゲームチェンジが欠かせません。当社は、これまでの強みを堅持しつつ、ALD材料や、エレクトロニクス・モビリティなどの分野で活躍する特殊樹脂、界面活性剤をはじめとする技術を結集し、後工程の技術革新に資する新規材料の創出へと領域を拡大することで、先端半導体における総合材料メーカーを目指します。

前工程

成膜	<強化> ALD（原子層堆積法）材料...高誘電材料（High-k）、Low-k、周辺材料、<次世代> ASD（選択的成膜）材料 など
リソグラフィ（露光）	<強化> 先端CAR（化学増幅型レジスト）向け光酸発生剤、MOR（金属酸化物レジスト）向け金属化合物 <次世代> 周辺材料 など
エッチング	<次世代> ALE（原子層選択エッチング）材料 など

後工程<次世代>

放熱	放熱シート、焼結型銅ペースト など
めっき代替	導電性銅ペースト、銅鋳体インク など
接合/接着	ハイブリッドボンディング向け接着剤、封止剤、ガラス接合低誘電シート/樹脂、先端パッケージ向けNCF（絶縁接着フィルム）、CPO（光電融合）向け接着剤 など

詳細は、以下ニュースリリース、メディア発表会資料をご参照ください。

ニュースリリース
(PDF : 961.7 KB)

メディア発表会資料
(PDF : 2.3 MB)

CONTACT

お問い合わせ